

## スパッタリング装置

基板上への薄膜形成

### [型式]

日本真空技術（株） SH-250H

### [仕様]

到達圧力： $1.3 \times 10^{-4}$ Pa

付着速度：基板固定時 350Å/min 以上

### [設置年度]

1993 年度（平成 5 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日